

동진세미켄, 반도체용 봉지재 국산화

반도체와 액정표시장치(LCD)용 화학재료 생산과 발포제 사업을 하고 있는 동진세미켄(대표 이부섭)이 광 반도체용 봉지재(Clear Compound)를 개발했다고 5월29일 밝혔다.

봉지재는 보통 Epoxy Molding Compound(EMC)를 말하며 반도체칩을 외부환경으로 보호하기 위해 감싸주는 역할을 한다.

동진세미켄이 개발한 봉지재는 외부 열과 습도 충격에서 보호하되 빛이 통과할 수 있도록 투명하게 만든 것이 특징이다.

반도체용 봉지재는 지금까지는 일본의 니토가 독점 공급했으나 동진세미켄이 3년간 10억원을 투자해 세계에서 2번째로 개발하는데 성공했다.

< Chemical Daily News 2002/ 05/ 31 >